

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

2021年2月19日投资者关系活动记录表

编号：2021-01

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他</p>
<p>参与单位 名称及人员姓名</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 兴业证券 章林2. 兴业证券 王楠3. 交银基金 郭斐4. 富国基金 王佳晨5. 宝盈基金 容志能6. 摩根华鑫基金 雷志勇7. 景顺长城基金 程振宇8. 国海富兰克林基金 张纯9. 安信基金 徐孙昱10. 信诚基金 杨柳青11. 国寿安保基金 张标12. 弘毅远方基金 赵阳13. 太平资产 陈晓华14. 华安财险 李阳15. 景泰利丰资产 吕伟志16. 财通资管 李晶17. 财通资管 黎来论18. 盘京投资 陈真洋

	<p>19. 开源证券 郑小凡</p> <p>20. 泰济朝合 张飞</p> <p>21. 海通自营 刘蓬勃</p> <p>22. 招商资管 何怀志</p>
时 间	2021 年 2 月 19 日
地 点	电话会议
上市公司 接待人员姓名	董秘、副总经理、财务总监董惠，研发中心主任赵东亮博士
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、基本情况</p> <p>中瓷电子 2021 年 1 月 4 日上市，是专门从事电子陶瓷系列产品的研发，生产和销售的高新技术企业。公司主要产品分为 4 大系列，主要是通信器件用的电子陶瓷外壳，工业激光器用的电子陶瓷外壳，消费电子陶瓷外壳和汽车电子件。电子陶瓷外壳类产品是高端半导体元器件中实现内部芯片与外部电路连接的重要桥梁，主要应用于光通信，无线通信，工业激光，电力电子，消费电子，5G，汽车电子等领域。中瓷电子始终坚持为“客户创造价值”的宗旨，秉承“自主创新、追求卓越”的发展理念，致力于成为世界一流的电子陶瓷供应商。</p> <p>二、提问环节</p> <p>1、问：介绍一下业务按照产品分类的构成，占比情况，特别想了解用在通信领域的电子陶瓷外壳分类，光通信占比多少？</p> <p>答：公司 4 大产品的占比情况招股说明书有详细介绍，通信器件用的陶瓷外壳是公司主要产品，占比 70%左右。通信器件用的电子陶瓷外壳包括光通信、无线和红外探测器类外壳，光通信类外壳占比最大。</p> <p>光通信类外壳产品用在核心器件光模块上，光模块核心功能是光的发射和接收，这是在电信、数据中心之间数据传输的关键器件。外壳是保证芯片功能能实现的元器件，包括把芯片电互联的关系引出来、控制端光能输出到光纤里等。目前市场主流是 100G 产品，之后有更高的 400G 产品。</p> <p>2、问：外壳价值量在光模块中的占比，不同速率产品价值量的占</p>

	<p>比？各种产品的收入占比及变化情况？</p> <p>答：价值量占比这是客户的信息，我们不了解。在不同速率产品之间不会有大的改变，外壳和芯片还是主要的两块。产品方面招股书等已详细介绍，募投项目针对的是消费电子方向，公司未来希望在消费电子方向有提升。</p> <p>3、问：现在 400G 全球来看已经进入量产，国内的 400G 供应商主要是国外的公司吗，咱们的差距有多大？国外在 400G 方面做得比较好的公司是哪些呢？</p> <p>答：目前市场主流还是 100G，400G 各家确实推出了方案，京瓷和我司都有 400G 产品供货，从使用的结果看，我司产品能够满足要求。</p> <p>4、问：陶瓷外壳是在全速率光模块都有应用是吗？</p> <p>答：是的，速率体现在传输。有些光开关，中间转换等等产品，我们是可以覆盖所有这些陶瓷外壳的。</p> <p>5、问：陶瓷外壳是不是用在气密性的，偏电信设备的光模块会多一些，如果是 TO 片的话是否需要外壳？</p> <p>答：目前公司产品除高速率的 BOX 产品外，也覆盖低速率的 10G、25G 的 TO-CAN 这样的产品。BOX 产品大部分是应用在一个大区域，大的城域网的核心的转换里面。如果是局域网或者小区、室内的这种的话，可能这种 TO 的，10G、25G 的比较多，相当于一个总路和一个分路的区别。</p> <p>6、问：公司在光模块的主要客户主要是用在电信侧的产品吗，数通侧应用怎么样？</p> <p>答：电信侧和数通两块都有。数通侧短距的话，非气密方案占主流，但是非气密方案里面会用到一些载体，这些载体我们也是有产品的。</p> <p>7、问：400G 和 100G 的陶瓷外壳的差异对公司来说体现在哪呢？</p> <p>答：400G 产品比 100G 产品的单价肯定要高，但是单位速率的价格在降低。</p> <p>8、问：请介绍下微型无引脚芯片外壳的应用？</p> <p>答：实现芯片简单的电路引出的一种外壳，价格低用量大。</p>
--	--

	<p>9、问：公司如何做外壳产品设计？</p> <p>答：客户要求，公司按客户要求进行定制化设计。</p> <p>10、问：请介绍下陶瓷外壳的市场占有率，光纤激光那些应用场景如何？和京瓷在相同的产品上的价格差距大不大？</p> <p>答：总体上公司小于日本京瓷的市场占有率，在无线通信、工业激光器等方面有很大的提升空间。现阶段客户对公司和京瓷的产品提出同等要求，按市场规则靠质量或价格优势取得订单。</p> <p>11、问：公司下游电信需求这一侧，20 年下半年和现在来看下游的景气度如何？</p> <p>答：公司在整个电信市场里占比很小，国家 5G 的建设等新基建的建设，除了要建 5G 基站以外，还包括主干网的搭建等，预计光模块领域总体还是上涨的趋势。</p> <p>12、问：陶瓷外壳这个产品是比较标准化的产品，还是需要跟光模块厂商合作研发、定制化的产品？</p> <p>答：大部分是定制产品，也有标准件。</p> <p>13、问：募投项目是关于消费电子的，请问募投项目的布局主要是指哪方面？客户开发怎么样？</p> <p>答：公司募投项目通过建设消费电子陶瓷生产线，生产声表晶振类外壳、3D 光传感器模块外壳（包括 3D sensor 用 VCSEL 外壳、汽车自动驾驶用激光雷达模块外壳）、5G 通讯用陶瓷外壳（包括通信终端用 TO 类外壳）系列化产品，开拓消费电子陶瓷产品领域。募投项目的建设具有明确的目标市场，能够改善公司的生产工艺、增强公司的生产能力最终促进公司的持续快速发展。</p> <p>14、问：公司在整个陶瓷粉体的布局情况以及自供比例的情况？会不会有高端的产品对粉体的精细度要求更高？对海外厂商在原材料上的依赖度怎么样？</p> <p>答：电子陶瓷和金属化体系关键核心材料是公司三大核心技术之一，其中陶瓷粉体等单一粉料，作为公司的外购原材料已实现国产化，公司的核心技术是包括氧化铝粉等多种材料的陶瓷配方、通过各项生产工艺</p>
--	---

来实现所需要的电子陶瓷的功能。针对高端低端产品系列化的材料，公司都有对应的核心技术。

15、问：客户每年对同一款产品的降价要求是怎么样的幅度？

答：公司没有年降的政策。如果量很大的话客户会跟我们有一个价格的协商，但没有年降策略。

16、问：请介绍公司跟国内三环集团产品的差异，以及现在和未来竞争的情况可以介绍一下吗？

答：公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D 光传感器模块外壳、5G 通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器等，广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。公司电子陶瓷外壳类产品是高端半导体元器件中实现内部芯片与外部电路连接的重要桥梁，对半导体元器件性能具有重要作用和影响。

潮州三环（集团）股份有限公司成立于 1970 年，是一家致力于研发、生产及销售电子基础材料、电子元件、通信器件等产品的综合性企业。公司产品覆盖光通信、电子、电工、机械、节能环保、新能源和时尚等众多应用领域，其中光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等产销量均居全球前列。

公司目前与三环集团主要产品无重合。

17、问：我在招股书里看到了我们 2020 年的经营情况，从收入端和利润端来看四季度单季度相比三季度环比是下降的，原因是什么？综合毛利率的水平也是向下的趋势，这个是不是因为我们的产品结构在变化的原因？

答：销售额是和公司当前季度符合收入确认的订单规模相关，是一个正常的波动。由于电子专用材料制造行业技术发展迅速，产品更新换代较快，同时全球化分工导致市场竞争充分，致使行业整体毛利率呈下降趋势。公司产品规格品种多样，产品结构的变化对公司毛利率波动也有一定影响。

18：问：能不能展望一下 2021 年各个业务线条增长趋势的情况？

	<p>答：目前从市场来说，5G 是国家大的布局，随着 5G 的发展我们的业务也会有发展。</p> <p>19、问：从公司股权结构来说，中国电科的占比较高，我们公司针对不同层次的人才的管理以及激励情况？第二个想请教一下我们的产品在汽车这块布局的情况？</p> <p>答：公司有全面的人才的管理以及激励制度，包括工资、福利、晋升、股权激励等，公司在符合上市公司以及国家规定的前提下，实施全面的人才管理及激励。</p> <p>公司汽车电子系列产品主要包括陶瓷元件、集成式加热器、车用检测模块等，广泛应用于滤清系统、发动机进排气系统，主要包括燃油加热器，油水分离器，温度、压力、流量传感器等。该产品需要满足国际通用的汽车零部件质量要求，可靠性和稳定性要求高。公司相关产品可用于 MCU、IGBT 等集成电路和功率芯片的封装，如公司作为牵头单位已完成国家科技重大专项“IGBT 用氮化铝封装技术研究及产业化”工作。</p> <p>以上内容未涉及内幕信息。</p>
附件清单（如有）	未提供书面材料。
日期	2021 年 2 月 19 日